

中信证券股份有限公司
关于
上海艾为电子技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
上市保荐书

保荐机构



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

二〇二一年四月

目 录

目 录.....	1
声 明.....	2
第一节 本次证券发行基本情况.....	3
一、发行人基本情况.....	3
二、本次发行情况.....	16
三、保荐人名称.....	16
四、保荐人与发行人的关联关系.....	17
第二节 保荐人承诺事项.....	19
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐意见.....	20
一、保荐意见.....	20
二、本次发行履行了必要的决策程序.....	20
三、发行人符合科创板定位.....	21
四、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件.....	22
五、对公司持续督导期间的工作安排.....	24

声 明

中信证券股份有限公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(以下简称“《科创板首发管理办法》”)和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等法律法规和中国证监会及上交所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整。

本文件中所有简称和释义,如无特别说明,均与招股说明书一致。

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

(一) 发行人基本信息

公司名称	上海艾为电子技术股份有限公司
英文名称	Shanghai Awinic Technology Co., Ltd.
注册资本	12,420.00 万元人民币
法定代表人	孙洪军
公司成立日期	2008 年 6 月 18 日
整体变更为股份公司日期	2014 年 12 月 23 日
注册地址	上海市闵行区秀文路 908 弄 2 号 1201 室
邮政编码	201199
电话	021-5296 8068
传真	021-6495 2766
互联网网址	www.awinic.com
电子邮箱	securities@awinic.com
负责信息披露和投资者关系部门	董事会秘书办公室
部门负责人	杨婷
电话	021-5296 8068
本次证券发行类型	首次公开发行股票并在科创板上市

(二) 发行人的主营业务

公司是一家专注于高品质数模混合信号、模拟、射频的集成电路设计企业，主营业务为集成电路芯片研发和销售。公司主要产品包括音频功放芯片、电源管理芯片、射频前端芯片、马达驱动芯片等，产品型号达到 470 余款，2020 年度产品销量约 32 亿颗，可广泛应用于以智能手机为代表的新智能硬件领域，主要细分市场还包括以智能手表和蓝牙耳机为代表的可穿戴设备，以平板和笔记本电脑为代表的智能便携设备，以 IoT 模块和智能音箱为代表的物联网设备及其他智能硬件等。公司已成为国内智能手机中数模混合信号、模拟、射频芯片产品的主要供应商之一。

（三）发行人的核心技术及研发水平

公司长期坚持数模混合信号、模拟和射频领域的研发和创新，围绕音频功放芯片、电源管理芯片、射频前端芯片、马达驱动芯片等产品市场积累了多项核心技术以及技术储备，以保证相关产品技术在行业内的优势地位。公司在音频功放产品领域形成了丰富的技术积累和完整的产品系列，在手机的高压模拟音频功放细分领域定义了产品规格和技术路线，引领了国内该细分领域的技术演进；在电源管理和射频前端领域持续扩充产品种类，快速渗透下游应用市场并持续进行拓展；在马达驱动产品领域进行长期的技术研发及积累，在国内企业中具有较强的竞争优势。

公司主要芯片产品的技术迭代周期一般为3年左右，公司各类芯片产品的迭代周期一般为12个月左右。公司下游以智能手机为代表的新智能硬件通常每1-2年会进行更新换代，但是公司的芯片产品非新智能硬件中的主芯片，公司在持续进行产品迭代的同时，通常相关芯片的技术迭代周期会长于新智能硬件本身的迭代周期。

公司在各产品领域的核心技术如下：



截至本上市保荐书签署日，公司掌握的主要核心技术情况如下：

序号	主要应用产品	核心技术名称	技术来源	主要应用和贡献
1	音频功放芯片	射频噪声抑制技术	自主研发	可抑制智能手机射频干扰噪声
2		双级 AGC 技术	自主研发	消除音乐播放中的杂音，有效保护喇叭
3		电磁干扰抑制技术	自主研发	有效减小音频功放输出信号对射频信号的干扰
4		防破音 NCN 技术	自主研发	有效减小截顶失真，消除破音，同时提升音乐音量
5		开环电荷泵技术	自主研发	提高电荷泵效率和驱动能力，提升功放整体效率

6		SKTune 算法技术	自主研发	保护喇叭和增强音效，提升音频的听音体验
7	电源管理芯片	端口保护技术	自主研发	主要应用于充电端口，对 PMIC 和充电芯片进行过压和浪涌保护
8		快速充电技术	自主研发	可实现对设备快速充电和电池动态路径管理，有效保护电池
9		开关电源技术	自主研发	在供电中高效率地进行升压和降压转换
10		音随我动算法	自主研发	呼吸灯效果随输入音乐变化而相应同步变化，实现炫彩的灯光效果
11		低亮度背光显式技术	自主研发	解决了超低亮度显示技术
12	射频前端芯片	低噪声放大器设计技术	自主研发	增益高、噪声系数低
13		大功率射频开关技术	自主研发	实现大功率信号处理能力、插损小，谐波性能好
14	马达驱动芯片	线性马达一致性自校准技术（LCC 技术）	自主研发	解决马达批次一致性、装配等因素导致的马达振动效果偏差
15		线性马达低延时驱动技术	自主研发	实现触觉反馈的低延时和快速响应
16		智能触觉反馈 4D 随音振动算法技术	自主研发	为游戏增加随图像和声音相关的振动效果

公司掌握的主要核心技术情况如下：

序号	核心技术名称	具体表征
1	射频噪声抑制技术	该技术采用独创的电路架构对传导和辐射干扰进行全方位抑制，使射频信号难以干扰到芯片内部，对 RFI 干扰衰减 60dB 以上，抑制射频干扰噪声
2	双级 AGC 技术	采用两级 AGC 算法，进行削波控制和喇叭保护功率控制，检测到削波后，极短时间内完成 10dB 衰减，抑制削波杂音，在提升音量的同时保护喇叭
3	电磁干扰抑制技术	通过控制功放输出边沿速率，有效抑制对射频信号的干扰
4	防破音 NCN 技术	防破音 NCN 技术检测到大信号超过设定阈值后，极短时间内完成 13.5dB 衰减，控制输出到喇叭的功率，有效保护喇叭
5	开环电荷泵技术	采用开环电荷泵 K-chargepump 技术，输出电压是输入电压的倍数，理论效率可以达到 100%，大幅提升整体效率
6	SKTune 算法技术	该技术在传统音效处理算法的基础上，结合手机小音腔的特点，可以根据输入信号的频率和幅度动态调整增益，在保护喇叭的同时显著增强音效
7	端口保护技术	本技术通过创新架构，提升保护响应速度，降低了输出残压，对后级芯片进行保护；完全满足 IEC61000-4-5 标准要求
8	快充技术	本技术用于穿戴设备充电，技术特点包括：最高 0.5A 充电电流，可实现穿戴设备小容量电池的快速充电；最小 2mA 充电截止电流，可让电池充的更满；输入电压范围-5V~28V，正负电压均可保护；具有过压保护、过流保护、反向漏电保护，短路保护，过热保护等多重保护功能；具有动态路径管理功能，支持 shipping

		mode
9	开关电源技术	该技术可根据后级需要调整降压和升压芯片的输出电压；显著提升效率干扰
10	音随我动算法	公司自创的音随我动算法，通过采样输入音频信号，通过特定的算法，可以正确反馈不同类型的音乐特效，让用户能随着音乐感受到环境光或者相应光条的变化
11	低亮度背光显示技术	该技术通过采用 Autozero 和指数调光算法等技术实现超低亮度显示，能控制 2nit 以下的光亮显示
12	低噪声放大器设计技术	国内首创的 OQ 低噪声技术，实现同等条件下更加良好的噪声性能
13	大功率射频开关技术	多级开关电压均匀技术，有效地实现了不同开关管之间分压均匀，实现同串级数下更高的功率处理能力。通过精确建模和驱动电路闭环调整完善，实现谐波和插损优化
14	线性马达一致性自校准技术（LCC 技术）	公司首创的线性马达一致性自校准技术（LCC 技术）包括如下三大检测校准功能：开机 F0 检测功能、F0 自动追踪功能、短振一致性自动校准功能；解决马达批次一致性、装配等因素导致马达实际 F0 偏差，提供给用户稳定震感的触觉反馈效果
15	线性马达低延时驱动技术	该技术通过内置触觉反馈波形，快速建立高压 boost 和硬件播放控制等技术，实现最大 1.2ms 的同类高压线性马达驱动产品最低延时，到达快速响应的效果。能在智能设备高频使用的情况下，始终维持快速的响应能力和振感反馈
16	智能触觉反馈 4D 游戏振动算法技术	公司首创在随音振动算法中结合使用图像动态检测、声音特征识别和用户操作识别等技术，适配多重场景的振动模式，智能识别游戏场景，通过清脆逼真的振动将游戏体验由屏幕的视觉感受立体地传递给用户

公司上述核心技术在音频功放芯片、电源管理芯片、射频前端芯片和马达驱动芯片等领域具有较强竞争力。

（四）发行人在报告期内的主要经营和财务数据及指标

项目	2020 年度/ 2020-12-31	2019 年度/ 2019-12-31	2018 年度/ 2018-12-31
资产总额（万元）	105,322.77	73,868.74	49,732.49
归属于母公司所有者权益（万元）	38,055.21	32,246.07	27,072.08
资产负债率（母公司）（%）	63.48	44.15	27.16
营业收入（万元）	143,766.37	101,764.99	69,380.44
净利润（万元）	10,168.95	9,008.89	3,829.75
归属于母公司所有者的净利润（万元）	10,168.95	9,008.89	3,829.75
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	8,970.89	8,161.79	5,093.26
基本每股收益（元）	0.82	0.73	0.31
稀释每股收益（元）	0.82	0.73	0.31
加权平均净资产收益率	29.22%	31.55%	16.05%

项目	2020 年度/ 2020-12-31	2019 年度/ 2019-12-31	2018 年度/ 2018-12-31
经营活动产生的现金流量净额(万元)	19,993.07	8,931.87	5,463.41
现金分红(万元)	4,140.00	6,624.00	-
研发投入占营业收入比例(%)	14.29	13.71	13.17

(五) 发行人的主要风险

1、经营风险

(1) 公司产品为通用型芯片，下游应用集中于智能手机领域，受下游智能手机出货量影响较大的风险

公司的芯片产品为通用型芯片，下游应用集中于智能手机市场，同时可应用于可穿戴设备、智能便携设备、物联网设备等领域。公司主要终端客户为华为、小米、OPPO、vivo、传音等知名手机品牌客户，以及华勤、闻泰科技、龙旗科技等知名 ODM 厂商。报告期各期公司对上述五家手机厂商的收入占比分别为 43.92%、46.67%和 51.16%，对上述三家 ODM 厂商的收入占比分别为 13.13%、23.05%和 26.69%，均呈上升趋势。

报告期内，经估算公司产品在智能手机市场的收入占比超过 85%，收入较为集中，全球智能手机市场的景气程度和出货量会影响智能手机品牌客户对公司芯片的使用需求。若未来智能手机市场需求萎缩造成智能手机出货量下降，将对公司未来盈利能力产生不利影响。

(2) 半导体行业需求增长导致晶圆及封测价格上涨的风险

公司为 fabless 运营模式下的芯片设计公司，对外采购的主要内容包括晶圆和封测，近年来随着半导体产业链国产化进程加快和国际产业链格局的变化，国内半导体行业的晶圆和封测需求快速上升，晶圆和封测产能逐步趋紧，采购价格整体呈上涨趋势。公司已通过加快产品迭代、选择先进生产工艺、自建测试中心等方式应对上游价格的上涨，未来如果上游产能紧张的形式加剧，或公司不能有效地应对采购价格上涨的影响，则将对公司的经营业绩产生不利影响。

(3) 市场竞争风险

集成电路行业受国家政策鼓励且发展迅速，行业内企业逐渐增多。一方面，行业内厂商在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，另一方面，新进入厂商也

不断抢夺市场份额，市场竞争逐渐加剧。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术和产品创新，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

此外，相较于公司 470 余种芯片产品型号，同行业集成电路国际巨头，如 TI 和 ADI，拥有上万种芯片产品型号，涵盖了下游大部分应用领域。一旦国际巨头企业采取强势的市场竞争策略与公司同类产品进行竞争，将会对公司造成较大的竞争压力，如公司不能实施有效的应对措施，及时弥补竞争劣势，将对公司的竞争地位、市场份额和经营业绩造成不利影响。

(4) 研发人员流失的风险

芯片设计属于技术密集型行业，行业壁垒较高。公司在经营过程中需注重产品的研发设计环节，凭借行业经验丰富、结构稳定的研发团队保证公司研发设计跟上新产品、新技术的发展。在未来业务发展过程中，若公司核心技术人员大量流失且公司未能物色到合适的替代者，将导致人才队伍建设落后于业务发展的要求，则可能会削弱公司的竞争力，并对公司生产经营产生不利影响。

(5) 产品质量风险

芯片产品的质量是公司保持竞争力的基础。公司已经建立并执行了较为完善的质量控制体系，但由于芯片产品的高度复杂性，公司无法完全避免产品质量的缺陷。若公司产品质量出现缺陷或未能满足客户对质量的要求，公司可能需承担相应的赔偿责任，并可能对公司经营业绩、财务状况造成不利影响。

(6) 供应商集中度较高的风险

公司采用 Fabless 模式经营，供应商包括知名的晶圆制造厂和封装测试厂。报告期内，公司与主要供应商保持了稳定的合作关系，公司向前五名供应商合计采购的金额分别为 50,619.62 万元、81,977.13 万元和 104,389.61 万元，占同期采购总额的比例分别为 94.32%、96.44%和 92.06%，供应商集中度较高。

由于集成电路领域专业化分工程度及技术门槛较高，集成电路设计公司出于工艺稳定性和批量采购成本优势等方面的考虑，往往仅选择个别晶圆厂和封装厂进行合作。未来若公司供应商业经营发生不利变化、产能受限或合作关系紧张，或由于其他不可抗力因素不能与公司继续进行业务合作，将对公司经营产生不利

影响。

2、技术风险

(1) 技术迭代风险

公司下游为以智能手机为代表的新智能硬件领域，终端客户产品更新换代较快，公司需要根据技术发展趋势和终端客户需求不断升级现有产品并研发新产品，从而保持技术先进性和产品竞争力。公司主要芯片产品的技术迭代周期一般为3年左右，公司各类芯片产品的迭代周期一般为12个月左右，以智能手机为代表的新智能硬件通常每1-2年会进行更新换代，但是公司的芯片产品非新智能硬件中的主芯片且为通用性芯片，公司在持续进行产品迭代的同时，通常相关芯片的技术迭代周期会长于新智能硬件本身的迭代周期。

由于公司下游终端客户多为知名品牌客户，其产品系列齐全，对公司产品型号有相对长期的使用需求，因此，公司大部分主要型号产品在上市后拥有5年以上的生命周期。如果公司不能根据行业及客户需求保持较快的技术迭代和技术迭代，不能保持持续的创新能力及贴紧下游应用的发展方向，并持续推出具有竞争力的新产品，将导致公司市场竞争力下降，并给公司未来业务拓展和经营业绩带来不利影响。

(2) 公司研发工作未达预期的风险

集成电路设计公司需要持续投入大量的资金和人员在现有产品的升级更新和新产品的开发工作中，以适应不断变化的市场需求。由于公司的技术成果产业化和市场化进程具有不确定性。如果未来公司在研发方向上未能正确做出判断，在研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期，或者研发出的产品未能得到市场认可，公司将面临前期的研发投入难以收回、预计效益难以达到的风险，将对公司业绩产生不利影响。

(3) 公司知识产权风险

截至2020年12月31日，公司已获得授权的专利共计232项，其中境内专利227项，境外专利5项。公司在业务开展过程中，存在公司的专有技术、商业秘密、专利或集成电路布图设计被盗用或不当使用，公司知识产权被监管机构宣告无效或撤销的风险，亦不排除公司与竞争对手产生知识产权纠纷的可能。此外，

公司存在未能及时对临近保护期限的知识产权进行续展的风险。同时，虽然公司一直坚持自主创新的研发战略，避免侵犯第三方知识产权，但仍不排除少数竞争对手采取恶意诉讼的市场策略，利用知识产权相关诉讼等拖延公司市场拓展，以及公司员工对于知识产权的理解出现偏差等因素出现非专利技术侵犯第三方知识产权的风险。

(4) 核心技术泄密风险

作为高新技术企业，技术优势以及持续的研发能力是公司主要的核心竞争力，也是公司保持技术领先和市场竞争优势的关键因素。公司拥有多项核心技术，为保护核心技术，公司通过与核心技术人员签订相关协议、规范化研发过程管理、申请专利、集成电路布图设计等保护措施防止核心技术泄密。但上述措施并不能完全保证核心技术不会泄露，若公司在经营过程中因核心技术信息保管不善、核心技术人员流失等原因导致核心技术泄密，将对公司业务发展和研发工作进程造成不利影响。

3、财务风险

(1) 公司业绩持续增长存在不确定性风险

报告期内，公司主营业务收入分别为 69,356.44 万元、101,764.99 万元及 143,766.37 万元，2018 年至 2020 年的复合增长率为 43.95%，保持了持续快速增长；公司扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润分别为 5,093.26 万元、8,161.79 万元和 8,970.89 万元，亦保持了持续增长。公司收入及净利润的持续增长主要系受下游需求增长、进口替代等因素影响，同时公司加强研发投入使得产品型号及销售规模逐渐增加。为增强公司的技术优势及产品竞争力，近年来公司不断增加研发投入，扩充人员规模，并加大在研发场所、研发测试设备等方面的固定资产投资。报告期内，公司的研发费用、人员规模、固定资产规模均呈现较快的增长态势。如果未来公司下游无法保持持续增长，公司无法保持在技术、产品及市场方面的竞争优势，或者公司未能妥善处理快速发展过程中的经营问题，公司将面临收入无法保持持续快速增长，或因成本费用大幅上升进而导致净利润无法持续增长的风险。

(2) 毛利率波动风险

报告期内，公司各类产品毛利率及综合毛利率均存在一定程度的波动。公司产品主要应用于以智能手机为代表的新智能硬件，产品毛利率水平主要受市场供求关系、产品技术先进性、产品更新迭代、公司销售及市场策略等因素综合影响。新产品推出时，为快速打开市场，毛利率水平可能相对较低，随着产品的迭代升级，毛利率水平会有所上升；受市场竞争影响，产品毛利率可能有所下滑；公司产品型号达 470 余款，不同型号产品销售结构的变化亦会对各类产品毛利率造成影响。由于公司各产品面临的市场竞争环境存在差异，各产品所在的生命周期阶段及更新迭代进度不同，产品的销售结构不同，公司存在因上述因素导致的毛利率波动风险。若公司未能根据市场变化及时进行产品技术升级，产品技术缺乏先进性，或公司市场推广未达预期造成高毛利产品销售占比下降，可能导致公司毛利率水平出现波动，进而对公司经营业绩产生不利影响。

(3) 汇率波动风险

因公司的海外业务通常以美元进行计价并结算，香港艾唯记账本位币为美元，同时公司存在较多的境内外母子公司关联交易，汇率波动将会对公司汇兑损益及其他综合收益——外币报表折算差造成影响。报告期内，公司汇兑损益金额分别为-127.65 万元、-323.62 万元和 1,417.60 万元，主要系外币交易过程中产生的已实现汇兑损益和期末持有的外币资产负债因汇率变动产生的未实现汇兑损益；报告期内，公司其他综合收益——外币报表折算差金额分别为 721.61 万元、3,510.71 万元及 3,290.90 万元，主要系香港艾唯的外币报表折算差及母子公司之间关联交易产生的汇率折算差。如果未来汇率出现大幅波动或者我国汇率政策发生重大变化，将造成公司经营业绩及所有者权益的波动。

(4) 存货规模较大及跌价风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品和在途物资构成。2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司存货账面价值分别为 18,894.88 万元、30,048.74 万元和 37,861.98 万元，存货价值增幅较大。公司根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，2018 年末、2019 年末和 2020 年末，公司存货跌价准备余额分别为 1,860.69 万元、2,787.71 万元和 2,455.30 万元，占同期存货账

面余额的比例分别为 8.96%、8.49%和 6.09%。若未来市场环境发生变化、竞争加剧或技术更新导致存货产品滞销、存货积压，将导致公司存货跌价风险增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

(5) 净资产收益率下降的风险

报告期内，公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为 21.34%、28.58%和 25.77%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的基本每股收益为 0.41 元/股、0.66 元/股和 0.72 元/股。本次发行完成后，公司净资产及总股本将在短时间内大幅增长，募集资金投资项目有一定的建设周期，项目产生效益尚需一段时间。因此，公司存在短期内净资产收益率及每股收益下降的风险。

(6) 税收优惠风险

公司享受的税收优惠税种主要为企业所得税。根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）的规定和《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号），公司符合国家规划布局内重点集成电路设计企业有关企业所得税税收优惠条件，按 10%的税率缴纳企业所得税。

报告期内，公司适用 10%的企业所得税税率，税收优惠金额占公司利润总额比重分别为 23.73%、26.01%和 16.22%。如果国家对集成电路企业的税收优惠政策发生变化，或者公司无法持续符合国家规划布局内重点集成电路设计企业的认定标准，无法通过其备案或认定，则公司无法享受按 10%的税率缴纳企业所得税，将会对公司未来经营业绩产生一定的负面影响。

4、内控风险

(1) 规模扩张导致的管理风险

报告期内，公司业务规模持续增长，相应的资产规模和人员规模也不断扩张。随着公司股票发行上市、募集资金投资项目的逐步实施，公司资产规模、人员规模、管理机构等都将进一步扩大，与此对应的公司经营活动、组织架构和管理体系将趋于复杂，对公司经营管理、资源整合、持续创新、市场开拓等方面都提出了更高的要求，经营决策和风险控制难度将进一步增加，公司管理团队的管理水

平及控制经营风险的能力将面临更大考验。如果公司管理团队的人员配备和管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，不能及时调整、完善组织结构和管理体系，提升管理层业务素质及管理水平，公司将面临因规模扩张带来的经营管理风险。

(2) 实际控制人风险

本次发行前，孙洪军先生直接持有本公司 56.01% 股权，并通过上海艾准及上海艾准的有限合伙人上海集为间接持有公司 0.01% 的股份，合计持有公司 56.02% 的股权。为公司实际控制人。本次发行完成后，预计孙洪军先生持股比例为 41.90%，仍对公司重大经营决策有实质性影响。若实际控制人利用其控股地位，对公司经营决策、利润分配等重大事项进行干预，将可能损害公司其他股东的利益。

5、募集资金投资项目相关风险

(1) 募集资金投资项目用地无法取得的风险

公司本次募集资金投资项目“研发中心建设项目”和“电子工程测试中心建设项目”需要在上海自由贸易试验区临港新片区取得土地并建设房屋。截至本上市保荐签署日，公司尚未取得项目用地的土地使用权。公司已与临港新片区就意向地块签署了《投资协议》，明确了目标地块的位置、面积等主要信息。公司目前正在积极办理土地购置相关事宜，若公司未能如期取得募投项目的国有土地使用权，将会对募集资金投资项目的实施产生不利影响。

(2) 募集资金投资项目效益未及预期的风险

公司本次募集资金投资项目主要针对音频功放芯片、射频芯片、马达驱动芯片、电源管理芯片进行新一代产品研发，如果研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期，或者未来市场的发展方向偏离公司的预期，致使研发出的产品未能得到市场认可，则募集资金投资项目将面临研发失败或市场化推广失败的风险，前期的研发投入将难以收回，募集资金投资项目预计效益难以实现，对公司业绩产生不利影响。

(3) 募集资金投资项目的管理和组织实施风险

公司募集资金投资规模较大，对公司管理大额资金和资金规划运作能力提出

了较高要求，多个募投项目同时实施也要求公司必须具备相应的组织能力和管理水平。募投项目实施后，公司的资产规模、业务规模及人员规模将进一步扩大，研发、运营和管理团队将相应增加，公司在人力资源、法律、财务、供应链等方面的管理能力需要不断提高。公司募集资金投资项目涉及房屋建设、装修等土建内容，亦对公司管理能力及项目实施能力提出挑战。如公司管理水平未随经营规模的扩大及时提升，将会对募集资金投资项目的按期实施及正常运转造成不利影响，进而会对公司经营发展带来不利影响。

(4) 募集资金投资项目新增固定资产及无形资产所产生折旧及摊销导致业绩下滑的风险

本次募集资金投资项目实施后，将陆续新增固定资产及无形资产投资，导致相应的折旧及摊销逐年增加，募投项目未来建设期四年折旧及摊销金额分别为 542.29 万元、1,574.78 万元、6,116.12 万元和 8,211.51 万元。如果因市场环境等因素发生变化，公司经营业绩成长水平或募集资金投资项目投产后盈利水平整体不及预期，新增折旧及摊销规模逐年增长，将对公司的经营业绩产生不利影响。

(5) 电子工程测试中心项目无法顺利实施的风险

电子工程测试中心项目的投资规模较大，涉及拓展芯片测试环节以支撑产品的创新发展，扩大自身的经营规模。该项目整体符合公司提高研发效率和增强测试能力从而扩大经营规模的核心需求，但测试属于芯片生产环节，公司业务以 Fabless 模式的芯片设计为主，截至本上市保荐出具日，公司仅开始自主测试业务的初步尝试且业务规模较小。如后续电子工程测试中心项目无法顺利实施，将对公司产品研发、测试能力和经营业绩产生不利影响。

6、其他风险

(1) 国际贸易摩擦风险

伴随全球产业格局的深度调整，国际贸易摩擦不断，集成电路产业成为贸易冲突的重点领域，也对中国相关产业的发展造成了客观不利影响。

集成电路是高度全球化的产业，如果国际贸易摩擦加剧，在销售端，公司终端客户可能会因为贸易摩擦受到不利影响，进而影响到公司向其销售各类产品，导致对公司的经营业绩产生一定不利影响；在采购端，公司主要晶圆供应商、EDA

软件供应商可能受到国际贸易政策的影响，进而影响其对公司的晶圆及 EDA 软件的供应，导致对公司采购产生一定不利影响。

(2) 新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营影响

新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，公司严格落实各级人民政府关于疫情防控工作的通知和要求，积极复工。疫情对中国经济和世界经济带来了较大影响，全球经济受疫情影响表现疲软，将直接打击终端智能手机等消费电子市场的需求，如果全球疫情在较长时间内不能得到有效控制，下游智能手机等消费电子市场需求减少或复苏缓慢，将对公司经营造成不利影响。

(3) 本次发行失败的风险

公司股票拟在上海证券交易所科创板上市，除公司经营和财务状况之外，预计市值还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响，存在未能达到预计市值上市条件的风险，以及因投资者认购不足而导致的发行失败风险。

(4) 证券市场风险

股票价格不仅取决于公司的经营业绩，国内外经济形势、政治环境、政府宏观调控政策、资本市场走势、投资者的投资心理和各类重大突发事件等因素都可能改变投资者的预期并影响证券市场的供求关系，进而影响二级市场股票估值。基于上述不确定性因素的存在，公司股票价格可能会脱离其实际价值而产生波动，存在投资风险。投资者应对股票市场的风险和股票价格的波动有充分的了解和认识。

(5) 即期回报被摊薄的风险

本次股票成功发行后，公司总股本和净资产将大幅增加，但募集资金投资项目的实施和达产需要一定的时间，项目收益亦需逐步体现。尽管公司未来几年收入、净利润可能增加，但募集资金到位后净利润增幅可能低于净资产的增幅，可能导致公司每股收益、净资产收益率短期内下降，公司存在即期回报被摊薄的风险。

二、本次发行情况

股票种类：	人民币普通股（A股）
每股面值：	1.00元
发行规模：	本次发行不超过4,180.00万股，公司股东不公开发售股份
每股发行价：	【】元
发行方式：	本次发行将采取向网下投资者询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会要求或认可的其他方式；最终的发行方式由股东大会授权董事会，根据中国证监会的相关规定确定
发行对象：	符合资格的询价对象和在上海证券交易所科创板开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象
拟上市证券交易所：	上海证券交易所

三、保荐人名称

中信证券指定彭捷、王彬为上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人；指定刘煜麟为项目协办人，指定鞠宏程、江肃伟、储成杰、宋凯、欧阳旭峰为项目组成员。

（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

彭捷，女，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组总监，保荐代表人，曾负责并参与寒武纪、圣邦股份、立讯精密、朗新科技、首都在线等IPO项目、某人工智能龙头公司CDR项目，国投中鲁定向增发、冠城大通公开增发、冠城大通可转债、立讯精密定向增发、瀛通通讯可转债、广联达定向增发、朗新科技可转债等再融资项目，创智科技、圣邦股份重大资产重组项目。

王彬，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组行政负责人，曾历任国泰君安证券投行部副总经理、总经理，平安证券投行事业部总经理，拥有保荐代表人和非执业注册会计师资格。曾主持和参与小米集团H股IPO及CDR申报、寒武纪IPO、石头科技IPO、首都在线IPO、华扬联众IPO、博通集成IPO、朗新科技IPO、创业慧康非公开发行、桑德环境配股、航天科技配股、建发股份配股、航天电子配股、中色股份配股、厦门中骏熊猫债、禹州集团熊猫债、中航高科重大资产重组、东北制药非公开发行、哈药集团重大资产重组等项目。

(二) 项目协办人保荐业务主要执业情况

刘煜麟,男,现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组高级副总裁,曾参与海天味业、丝路视觉、海能实业、道通科技等 IPO 项目,并参与赣锋锂业、新国都、掌趣科技、圣邦股份等并购及再融资项目,以及某人工智能龙头公司 CDR 和投资汉得信息等其他财务顾问业务。

(三) 项目组其他人员情况

鞠宏程,男,保荐代表人,现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组副总裁,保荐代表人,曾就职于德意志银行(纽约)资产管理部。项目经验包括博创科技 IPO 项目、丽人丽妆 IPO 项目、博通集成 IPO 项目、澜起科技科创板 IPO 项目、普冉半导体科创板 IPO 项目、泰坦科技科创板 IPO 项目、苏宁、携程集团资本运作项目、某大型互联网电商 CDR 项目等。

江肃伟,男,现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组副总裁,曾就职于国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。项目经验包括中新赛克 IPO 项目、任子行重大资产重组项目、誉衡药业再融资项目、仟源医药再融资项目、以及某国资控股权收购、可交换债券项目。

储成杰,男,现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组高级经理,参与了斯达半导体主板 IPO 项目、澜起科技科创板 IPO 项目、泰坦科技科创板 IPO 项目、丽人丽妆主板 IPO 项目、瑞能半导科创板 IPO 项目等资本运作项目。

宋凯,男,现任中信证券投资银行管理委员会信息传媒行业组高级经理,拥有非执业注册会计师资格,参与了创智和宇 A 股 IPO 项目、华如科技 A 股 IPO 项目等资本运作项目。

欧阳旭峰,男,现任中信证券投资银行管理委员会高级经理,参与了普冉半导体 IPO、丽人丽妆 IPO、泰坦科技 IPO、联想控股公司债等资本运作项目。

四、保荐人与发行人的关联关系

(一) 本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、重要关联方股份情况

截至本上市保荐书签署日,本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联

方未持有发行人或其控股股东、重要关联方股份。

（二）发行人或其控股股东、重要关联方持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况

除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，截至本上市保荐书签署日，发行人或其控股股东、重要关联方未持有本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份。

（三）本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人或其控股股东、重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、重要关联方任职的情况

截至本上市保荐书签署日，本保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人或其控股股东、重要关联方股份的情况，也不存在在发行人或其控股股东、重要关联方任职的情况。

（四）本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

截至本上市保荐书签署日，本保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系

截至本上市保荐书签署日，本保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

第二节 保荐人承诺事项

一、保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

本保荐机构同意推荐上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。

二、保荐机构有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定。

三、保荐机构有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、保荐机构有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理。

五、保荐机构有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异。

六、保荐机构保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查。

七、保荐机构出具的上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

八、保荐机构保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范。

九、保荐机构自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。

十、若因保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成经济损失的，将依法赔偿投资者损失。

第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐意见

一、保荐意见

本保荐人根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》《科创板首发管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）《保荐人尽职调查工作准则》、《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》（证监会公告[2012]14号）和《关于做好首次公开发行股票公司年度财务报告专项检查工作的通知》（发行监管函[2012]551号）《关于修改〈首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定〉的决定》（证监会公告[2014]11号）等法规的规定，由项目组对发行人进行了充分的尽职调查，由内核会议进行了集体评审，认为：发行人具备《证券法》《科创板首发管理办法》和《科创板股票上市规则》等相关法律法规规定的首次公开发行股票并在科创板上市的条件。发行人具有自主创新能力和成长性，法人治理结构健全，经营运作规范；发行人主营业务突出，经营业绩优良，发展前景良好；本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策，符合发行人的经营发展战略，能够产生良好的经济效益，有利于推动发行人持续稳定发展。因此，本保荐人同意对发行人首次公开发行股票并在科创板上市予以保荐。

二、本次发行履行了必要的决策程序

（一）董事会决策程序

2020年9月8日，发行人召开了第二届董事会第二十三次会议，全体董事出席会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票及上市的议案》等相关议案。

（二）股东大会决策程序

2020年9月24日，发行人召开了2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票及上市的议案》等相关议案。

综上，本保荐人认为，发行人本次发行已获得了必要的批准和授权，履行了

必要的决策程序，决策程序合法有效。

三、发行人符合科创板定位

(一) 艾为电子符合科创板定位要求的具体情况

根据《科创属性评价指引（试行）》的要求，公司符合相关规定：

1、公司符合行业领域要求

公司所属行业领域	<input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术	根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，属于新一代信息技术领域。因此，公司符合科创板行业领域要求
	<input type="checkbox"/> 高端装备	
	<input type="checkbox"/> 新能源	
	<input type="checkbox"/> 节能环保	
	<input type="checkbox"/> 生物医药	
	<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域	

2、公司符合科创属性要求

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例 $\geq 5\%$ ，或最近三年累计研发投入金额 $\geq 6,000$ 万元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2018-2020 年公司研发投入分别为 9,137.14 万元、13,947.05 万元、20,537.85 万元，累计 43,622.04 万元，超过 6,000.00 万元
形成主营业务收入的发明专利（含国防专利） ≥ 5 项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司拥有主营业务相关的境内已授权发明专利共计 78 项
最近三年营业收入复合增长率 $\geq 20\%$ ，或最近一年营业收入金额 ≥ 3 亿	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	最近三年公司营业收入分别为 69,380.44 万元、101,764.99 万元和 143,766.37 万元，最近三年复合增长率为 43.95%，且最近一年收入超过 3 亿元

根据公司情况与《科创板首发管理办法》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》等相关法律法规中关于科创板定位要求的逐条比对，公司符合科创板定位要求。

(二) 保荐机构核查过程及意见

本保荐机构访谈了公司主要管理人员，了解公司业务经营情况及技术情况；获取了公司专利、软件著作权等知识产权证书；走访了商标局、专利局等相关政府部门；审阅了公司员工花名册及员工简历，了解公司研发人员情况；获取了公司主要采购及销售合同，了解公司客户及供应商情况，并对公司主要客户与供应

商进行了现场走访；收集并审阅了行业研究报告，了解最新行业动态、技术特点等行业信息。

经核查，保荐机构认为艾为电子归属新一代信息技术，面向国家需求，符合国家战略，符合保荐机构优先推荐科创板上市的要求。艾为电子拥有关键核心技术，科技创新能力突出，自成立以来得到了市场的广泛认可，且具备保持持续研发创新的能力。公司主要依靠核心技术开展生产经营，且经营情况良好。艾为电子符合科创板定位要求。

四、发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件

公司股票上市符合《证券法》和《科创板首发管理办法》、《科创板股票上市规则》规定的上市条件：

（一）发行人本次发行前股本总额为 12,420.00 万股，本次拟公开发行不超过 4,180.00 万股，发行后股份总数不超过 16,600.00 股，公开发行的股份不低于发行后股份总数的 25%；

（二）市值及财务指标

1、市值指标

（1）可比上市公司比较法

1) 可比公司选取

保荐机构通过 Wind 数据系统进行筛选，最终选取了以下 4 家上市公司作为对比公司：

序号	公司名称	公司简介
1	圣邦微电子（北京）股份有限公司 (简称：圣邦股份，股票代码：300661.SZ)	圣邦股份是一家专注于高性能、高品质模拟集成电路芯片设计及销售的高新技术企业，主营业务为模拟芯片的研发与销售。公司自成立以来一直专注于模拟芯片的研发和销售，主要产品为高性能模拟芯片，覆盖信号链和电源管理两大领域，拥有1,400多款可供销售产品，可广泛应用于通讯、消费类电子、工业控制、医疗仪器、汽车电子等众多领域，终端客户近两千家。
2	江苏卓胜微电子股份有	卓胜微的主营业务为射频前端芯片的研究、开发与销售，

序号	公司名称	公司简介
	限公司 (简称: 卓胜微, 股票代码: 300782.SZ)	主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器等射频前端芯片产品, 并提供IP授权, 应用于智能手机等移动智能终端。公司的射频前端芯片应用于三星、小米、华为、vivo、OPPO、联想、魅族、TCL等终端厂商的产品。
3	无锡芯朋微电子股份有限公司 (简称: 芯朋微, 股票代码: 688508.SH)	芯朋微主营业务为电源管理集成电路的研发和销售。公司专注于开发电源管理集成电路, 实现进口替代, 为客户提供高效能、低功耗、品质稳定的电源管理集成电路产品, 推动整机的能效提升和技术升级, 目前在产的电源管理芯片共计超过500个型号。公司是国内智能家电、标准电源、移动数码等行业电源管理芯片的重要供应商, 知名终端客户主要包括美的、格力、创维、飞利浦、苏泊尔、九阳、莱克、中兴通讯、华为等。
4	思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(简称: 思瑞浦; 股票代码: 688536.SH)	思瑞浦是一家专注于模拟集成电路产品研发和销售的集成电路设计企业。自成立以来, 公司始终坚持研发高性能、高质量和高可靠性的模拟集成电路产品, 目前已拥有超过900款可供销售的产品型号。公司的产品以信号链模拟芯片为主, 并逐渐向电源管理模拟芯片拓展, 其应用范围涵盖信息通讯、工业控制、监控安全、医疗健康、仪器仪表和家用电器等众多领域。

资料来源: Wind 资讯

2) 比率乘数选择

保荐机构选择市盈率作为预计公司未来市值的比率乘数, 根据 Wind 数据, 可比公司的估值指标如下表所示:

公司名称	市值(亿元)	市盈率(TTM)	市盈率(TTM, 扣非)
圣邦股份	361.85	137.50	144.78
卓胜微	1,128.55	105.20	109.60
芯朋微	78.17	78.38	110.64
思瑞浦	288.64	156.34	441.15
平均值	464.30	119.36	201.54

注: 上述数据为截至 2021 年 3 月 31 日的数据, 数据来源 Wind 资讯

3) 可比上市公司比较法的评估结果

截至 2021 年 3 月 31 日, 艾为电子在全国中小企业股份转让系统的市值为 243 亿元。

艾为电子 2020 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为 10,168.95 万元, 扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润为 8,970.89 万元, 参考同行业可

比公司平均市盈率（扣非后），艾为电子预计市值不低于 10 亿元。

（2）市值结论

根据本上市保荐书，发行人预计市值不低于 10 亿元，满足上述上市标准中“预计市值不低于人民币 10 亿元”的要求。

2、标准适用判定

发行人结合自身状况，选择适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条规定的上市标准中的“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”

根据本上市保荐书，发行人预计市值不低于 10 亿元，满足上述上市标准中“预计市值不低于人民币 10 亿元”的要求。同时，发行人 2019 年和 2020 年的净利润分别为 9,008.89 万元和 10,168.95 万元，发行人 2020 年营业收入为 143,766.37 万元，满足上述上市标准中“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”或“最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。”的要求。

综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。

五、对公司持续督导期间的工作安排

事项	工作安排
（一）持续督导事项	在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度内对发行人进行持续督导
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、实际控制人、其他关联机构违规占用发行人资源的制度	强化发行人严格执行中国证监会和上海证券交易所相关规定的意识，进一步完善各项管理制度和发行人的决策机制，协助发行人执行相关制度；通过《保荐及承销协议》约定确保保荐机构对发行人关联交易事项的知情权，与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度	督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若有关的关联交易为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定执行，对重大的关联交易本机构将按照公平、独立的原则发表意见

事项	工作安排
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	督导发行人按照《募集资金管理及使用制度》管理和使用募集资金；定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守《公司章程》、《对外担保制度》以及中国证监会关于对外担保行为的相关规定
7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况	与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息
8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查	定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行实地专项核查
(二) 保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议约定的方式，及时通报与保荐工作相关的信息；在持续督导期间内，保荐机构有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，督促发行人做出说明并限期纠正，情节严重的，向中国证监会、上海证券交易所报告；按照中国证监会、上海证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	发行人及其高管人员以及为发行人本次发行与上市提供专业服务的各中介机构及其签名人员将全力支持、配合保荐机构履行保荐工作，为保荐机构的保荐工作提供必要的条件和便利，亦依照法律及其它监管规则的规定，承担相应的责任；保荐机构对发行人聘请的与本次发行与上市相关的中介机构及其签名人员所出具的专业意见存有疑义时，可以与该中介机构进行协商，并可要求其做出解释或者出具依据
(四) 其他安排	无

(以下无正文)

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于上海艾为电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

保荐代表人:

彭捷

彭捷

2021年4月22日

王彬

王彬

2021年4月22日

项目协办人:

刘煜麟

刘煜麟

2021年4月22日

内核负责人:

朱洁

朱洁

2021年4月22日

保荐业务负责人:

马尧

马尧

2021年4月22日

总经理:

杨明辉

杨明辉

2021年4月22日

董事长、法定代表人:

张佑君

张佑君



保荐机构: 中信证券股份有限公司

2021年4月22日